MERCURYWAVE 9350
MERCURYWAVE 9350B

射频和微波
层压板和半固化片

优点
- 稳定的 Dk/Df 控制
- 适用多频段范围稳定的介电性能
- 适用射频基板技术
- 适用各种复杂结构设计

产品应用
- 基站组件和设备
- 汽车
- 卫星通信
- 军事制导与雷达
- 宽带射频天线

Mercurywave 9350 和 Mercurywave 9350B 是针对射频和微波市场需求而量身定制的非聚四氟乙烯、高频、低损耗树脂体系材料。该材料具有低损耗电气性能和高热可靠性，为设计高性能射频和微波基板提供了更大的灵活性与自由度。

优异的电气性能
- 层压板和半固化片 Dk/Df 都是可控的
- Dk/Df 相对于频率和温度变化较为稳定
- 低插损，低 PIM
- 较强的抗老化性

良好的热性能与机械性能
- 出色的散热性能
- 低 Z 轴膨胀
- 可承受多次 260℃回流焊组装循环
- 剥离强度高
- 高 Tg 材料

加工
- 在 193℃ 温度和 275-350 psi 压力下固化 120 分钟

规格
- UL 94V-0，额定 50℃ 最大操作温度 (MOT)
- 符合并超过 IPC-4101/29、IPC-4103/240 标准
- **UL档案号：E36295**

属性	条件	典型值	单位	试验方法
电气性能				
介电常数	@ 2.5 GHz	3.7		
	@ 10 GHz	3.5		IPC-TM-650.2.5.5.5
损耗因子	@ 2.5 GHz	0.004		
	@ 10 GHz	0.004		IPC-TM-650.2.5.5.5
体积电阻率	C - 96 / 35 / 90	7.0×10^7	MΩ - cm	IPC-TM-650.2.5.17.1
	E – 24 / 125	7.4×10^6		
表面电阻率	C - 96 / 35 / 90	6.6×10^5	MΩ	IPC-TM-650.2.5.17.1
	E - 24 / 125	4.7×10^6		
电气强度		5.9×10^4 (1500)	V/mm (V/mil)	IPC-TM-650.2.5.6.2
热性能				
*玻璃化转变温度 (Tg)	DMA(°C) (Tan d Peak)	>200	°C	IPC-TM-650.2.4.24.2
裂解温度 (Td)	Degradation Temp (TGA) (5% wt. loss)	360	°C	IPC-TM-650.2.3.40
T-260	Time to delamination @ 260°C	200	minutes	IPC-TM-650.2.4.24.1
导热系数		0.50	W/mK	ASTM E1461
机械性能				
剥离强度	1 oz (35µ) Cu After Solder Float	1.22 (7.0)	N/mm (lbf/inch)	IPC-TM-650.2.4.8
X / Y CTE	-40°C to + 125°C	10 / 14	ppm/°C	IPC-TM-650.2.4.41
Z 轴 CTE Alpha 1 / Alpha 2 (55% RC)	50°C to Tg / Tg to 260°C	48 / 245	ppm/°C	IPC-TM-650.2.4.24
Z 轴膨胀系数 (43% RC)	50°C to 260°C	2.5	%	IPC-TM-650.2.4.24
杨氏模量 (X / Y)		2.1^{10} / 2.5^{10} (3.0 / 3.7)	GN/m^2 (psi x 10^6)	ASTM D3039
泊松比 (X / Y)		0.14 / 0.17		
物理/化学性能				
吸水率		0.15	wt. %	IPC-TM-650.2.6.2.1

*DMA 是测量 Tg 的首选方法 - 其他方法测量值仅供参考。

- 提供的所有试验数据均为典型值，并非规范值。如需查看关键规格公差，请直接联系公司代表。
- Meteorwave® 9350 & 9350B 可制造的层压板厚度为 2mil（0.05 毫米）及以上。
- Meteorwave® 9350 & 9350B 提供最常见的面板尺寸。
- 请联系 AGC 了解能否提供任何其他结构、铜厚和玻璃布种类，包括超低粗糙度铜箔和 RTFOIL®。